

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ	
<b>НОВЫЕ СЕРИИ DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ КОМПАНИИ PICO ELECTRONICS</b> <i>Верхулевский К.</i>	6-11
<b>ГИБРИДНЫЕ DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КОМПАНИИ MODULAR DEVICES</b> <i>Саммер С.</i>	14-16
<b>ММОДУЛЬ LTM4646 - СОВРЕМЕННОЕ КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПИТАНИЯ</b> <i>Рентюк В., Ильин В.</i>	18-22
<b>СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ IOT С БАТАРЕЙНЫМ ПИТАНИЕМ</b> <i>Робертс С., Алькантара М., Дубицкий А.</i>	24-26
<b>ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ СОБСТВЕННЫХ ЭМП ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ</b> <i>Армстронг Т., Русских М.</i>	28-30
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ	
<b>МИКРОСХЕМА РЕГУЛИРУЕМОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 5318EP015 КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА "ВП"</b>	32
КОМПОНЕНТЫ	
<b>СВЧ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ. ЧАСТЬ 3. ВИДЫ КОРПУСИРОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ</b> <i>Дингес С., Кочемасов В.</i>	33-42
<b>РЕШЕНИЯ HSAUTOLINK КОМПАНИИ MOLEX ДЛЯ СИСТЕМ V2V-КОММУНИКАЦИИ</b> <i>Рентюк В.</i>	44-47
<b>МИКРОСХЕМЫ LOW-LATENCY DRAM ОТ GSI TECHNOLOGY</b> <i>Павлюкович Е.</i>	49-51
<b>ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРНЫХ ЯДЕР. ЧАСТЬ 5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ</b> <i>Тарасов И.</i>	52-57
<b>ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ ПЛИС ФИРМЫ XILINX В САПР СЕРИИ VIVADO HLX DESIGN SUITE</b> <i>Зотов В.</i>	59-70
<b>УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ПРИ МИНИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ</b> <i>Смит Д., Уэйкфилд Э.</i>	72-75
<b>МЕЖПРОЦЕССОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (IPC) В МНОГОЯДЕРНЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ. ЧАСТЬ 4. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКАМИ В I.MX6SX</b> <i>Самоделов А.</i>	76-84
АВТОМАТИЗАЦИЯ	
<b>ГЕТЕРОГЕННАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСОВ M2M В АСКУЭ</b> <i>Гусаров А.</i>	86-89
ПРОЕКТИРОВАНИЕ	
<b>ГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА TOUCHGFX</b> <i>Долгушин С.</i>	90-96
<b>ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА USB TYPE-C</b> <i>Erik Babbé Э.</i>	97-99
<b>ПРОБЛЕМА ИЗЛУЧЕНИЯ ЭМП СИЛОВЫМ ДРОССЕЛЕМ DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ВАРИАНТЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ</b> <i>Браманпалли Р., Рентюк В.</i>	101-108

<b>МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ БЛОКОВ ИМПУЛЬСНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ MICROCAP</b> <i>Лиференко В., Соколов О., Колесник Д.</i>	110-114
<b>ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ К ЭМИ ЯВ: ФАКТЫ И СЛЕДСТВИЯ</b> <i>Гуревич В.</i>	116-122

#### ТЕХНОЛОГИИ

<b>НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕРМОПОДЛОЖЕК - АКРИЛОВЫЙ ЭЛАСТОМЕР</b> <i>Пескова С.</i>	126-128
<b>ОСЦИЛЛОГРАФЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В ПОЛОСЕ ДО 8 ГГЦ: НОВАЯ СЕРИЯ TELEDYNE LECROY WAVEPRO HDR</b> <i>Шиганов А.</i>	130-132
<b>БЫСТРАЯ ВЫГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ ЦИФРОВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА R&amp;S RTO</b> <i>Флемминг Э.</i>	134-135